

SEMINARE TERMINE – 2. HALBJAHR 2018



+49 30 46069009

seminaranfrage@bond-iq.de

▶ **10. – 11. September**

Drahtbondseminar Teil 1 – Bondverfahren, Materialien, Einflussfaktoren (Starter – Level)

Preis: 1.150 € pro Teilnehmer

Dauer: 2 Tage (9 – 16 Uhr)

Wer: Bediener, Technologie-Einsteiger, Fertigungsplaner, techn. Einkauf

NOCH WENIGE PLÄTZE VERFÜGBAR

▶ **27. – 28. September**

Drahtbondseminar Teil 2 – Qualität, Zuverlässigkeit, Fehleranalyse (Engineer – Level)

Preis: 1.450 € pro Teilnehmer

Dauer: 2 Tage (9 – 16 Uhr)

Wer: Qualitätsverantwortliche, Entwickler, techn. Leitungsebene, SQM,
Vorentwicklung, Fortgeschrittene Prozessbetreuer/Bediener

AUSGEBUCHT

▶ **10.-11. Oktober**

Drahtbondseminar Teil 3 – Prozessoptimierung, DOE, Ursachenfindung (Specialist – Level)

Preis: 1.850 € pro Teilnehmer

Dauer: 2 Tage (9 – 16 Uhr)

Wer: Entwicklung, Prozessentwicklung, Produktionsverantwortliche

NOCH WENIGE PLÄTZE VERFÜGBAR

▶ **7. – 9. November**

Kompaktseminar Drahtbondtechnologie – im Schnelleinstieg zu Technologiekompetenz

Preis: 2.250 € pro Teilnehmer

Dauer: 3 Tage (9 – 17 Uhr)

Wer: Projektmanager, Innovatoren, Entwicklung, techn. & strateg. Leitungsebene, SQM,
Qualitätsverantwortliche, Geschäftsführung

▶ **12. – 13. November**

Drahtbondseminar Teil 3 – Prozessoptimierung, DOE, Ursachenfindung (Specialist – Level)

Preis: 1.850 € pro Teilnehmer

Dauer: 2 Tage (9 – 16 Uhr)

Wer: Entwicklung, Prozessentwicklung, Produktionsverantwortliche

AUSGEBUCHT

SEMINARE TERMINE – 2. HALBJAHR 2018



+49 30 46069009

seminaranfrage@bond-iq.de

▶ **19. – 20. November**

Drahtbondseminar Teil 3 – Prozessoptimierung, DOE, Ursachenfindung (Specialist – Level)

Preis: 1.850 € pro Teilnehmer

Dauer: 2 Tage (9 – 16 Uhr)

Wer: Entwicklung, Prozessentwicklung, Produktionsverantwortliche

AUSGEBUCHT

▶ **28. – 30. November**

Kompaktseminar Bare – Die Verarbeitung – Grundlagen der Die – Attach und Flip – Chip Montage

Preis: 1.450 € pro Teilnehmer

Dauer: 2 Tage (9 – 16 Uhr, optional: ½ Zusatztag für individuelle Versuche – Tag 3 von 9 – 13 Uhr)

Wer: Bediener, Technologie-Einsteiger, Fertigungsplaner, Entwickler, Prozessverantwortliche, Projektmanager, Innovationstreiber

▶ **11. – 12. Dezember**

Drahtbondseminar Teil 4 – Zuliefererqualität, Schichtsysteme, Fehleranalytik

Preis: 1.850 € pro Teilnehmer – **2018 noch zum Einführungspreis von 1.295 € pro Teilnehmer**

Dauer: 2 Tage (9 – 16 Uhr)

Wer: Entwicklung, SQM, Produktionsverantwortliche, Qualitätsverantwortliche